

2015-2020年中国键合金丝 行业分析与投资前景研究调查报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国键合金丝行业分析与投资前景研究调查报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinshu1501/Y67504F880.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-01-18

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国键合金丝行业分析与投资前景研究调查报告》共九章。介绍了键合金丝行业相关概述、中国键合金丝产业运行环境、分析了中国键合金丝行业的现状、中国键合金丝行业竞争格局、对中国键合金丝行业做了重点企业经营状况分析及中国键合金丝产业发展前景与投资预测。您若想对键合金丝产业有个系统的了解或者想投资键合金丝行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

集成电路中用作连接线的金合金丝，又称球焊金丝或引线金丝。金含量 $\geq 99.99\%$ ，微量添加元素总和 $\leq 0.01\%$ 。有 γ 型、C型和FA型等三种，后两种用于高速键合。微量元素为铍、铜、银等具有细化晶粒，提高再结晶温度和强化金的作用。用高频炉真空熔炼，二次重熔和定向结晶，铸锭在均匀化后冷加工成材。或用液体挤压工艺制造。键合金丝是微电子工业的重要材料，用作芯片和引线框架间连接线。

报告目录：

第一章 微电子封装技术与产业状况11

第一节 微电子封装及其功能11

第二节 IC封装产品与技术发展11

一、从IC封装产品发展顺序看封装的技术进步11

二、当前主流的封装产品与技术14

三、IC封装产品品种的发展趋势14

第三节 世界IC封装产业状况14

一、世界IC封装产业总体现状14

二、世界主要IC封装测试厂商16

三、世界IC产业发展趋势17

四、国内IC封装产业状况21

第二章 键合丝的产品综述22

第一节 键合丝的品种及其特性22

一、键合金丝22

二、键合铝丝22

三、键合铜丝22

四、各种键合丝特性的对比25

第二节 引线键合技术27

一、热压键合法27

二、超声键合法27

三、热超声键合法28

四、引线键合的两种基本形式28

第三节 键合丝主要常用标准28

第四节 键合丝材料主要涉及专利、标准29

一、涉及专利29

二、主要行业标准30

第三章 世界键合丝产业现状与市场需求分析32

第一节 世界键合丝行业现状及市场规模预测32

第二节 世界键合金丝的主要生产企业情况33

第四章 我国键合金丝行业发展综述36

第一节 我国键合金行业发展现状36

一、市场需求增幅较大36

二、行业利润空间缩小，恶性竞争普遍存在36

三、企业面临新的挑战 and 重组势在必行36

四、欧盟RoSH法令实施的影响分析36

五、外资企业加快进入中国市场，国内企业两极分化严重36

六、行业向规模化、无铅环保化方向发展37

第二节 主要地区分析37

一、长三角地区37

二、山东省37

三、其它地区38

第三节 应用领域需求分析38

一、发光二极管38

二、三极管39

三、低端IC (DIP、SOP等40

第五章 我国键合金丝市场总体概况47

第一节 我国键合金丝生产情况分析47

一、我国键合金丝生产总体概况分析47

二、我国键合金丝在建拟建项目分析47

三、我国键合金丝未来生产情况预测分析	48
第二节 我国键合金丝原材料供应状况分析	49
一、主要原材料	49
二、主要原材料历史价格及供应情况	52
三、主要原材料当前价格及供应情况	53
四、主要原材料未来价格及供应情况预测	54
第六章 我国键合金丝竞争格局分析	57
第一节 市场竞争现状分析	57
第二节 企业市场占有率分析	57
第三节 市场供给现状	57
第四节 我国键合金丝市场竞争格局分析	58
一 市场整体格局分析	58
二 市场竞争格局走势分析	58
第七章 主要生产企业	60
第一节、全球三大企业分析	60
一、田中贵金属工业株式会社	60
二、贺利氏控股集团	62
三、住友金属矿山株式会社	65
第二节、国内主要企业分析	68
一、贺利氏招远贵金属材料有限公司	68
二、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司	71
三、杭州菱庆高新材料有限公司	74
四、杭州日茂新材料有限公司	77
五、宁波康强电子股份有限公司	79
六、北京达博有色金属焊料有限责任公司	88
七、烟台招金励福贵金属有限公司	91
八、贵研铂业股份有限公司	94
第八章 我国键合金丝产业发展中存在的问题及行业发展趋势	105
第一节 我国键合金丝产业发展中存在的问题	105
一、原材料成本方面	105
二、研发方面	105
第二节 我国键合金丝行业发展趋势分析	105

一、键合金丝总体发展趋势	105
二、键合金丝产业及技术发展趋势	105
第九章 博思数据关于行业投资机会与风险分析	107
第一节 投资机会分析	107
第二节 投资风险分析	107
一、政策风险	107
二、经营风险	107
三、技术风险	108
四、进入退出风险	109

图表目录：

图表 1 封装的功能	11
图表 2 全球十大专业封装厂商	16
图表 3 2013年度我国半导体封装测试行业销售额前十名企业	21
图表 4 不同键合丝电阻率对比	23
图表 5 金属间化合物生长规律	24
图表 6 不同键合丝机械性能对比	24
图表 7 各种键合丝特征对比	26
图表 8 各种键合丝优缺点对比	26
图表 9 2012-2014年9月我国长三角地区键合金丝生产分析	37
图表 10 2012-2014年9月我国山东地区键合金丝生产分析	37
图表 11 2012-2014年9月我国其它地区键合金丝生产分析	38
图表 12 2008-2013年我国集成电路行业增长情况	40
图表 13 2013年集成电路出口分季度增长情况	41
图表 14 2013年集成电路行业投资按月增长情况	42
图表 15 2008-2013年我国集成电路产业投资情况	43
图表 16 2012-2014年9月我国键合金丝生产量分析	47
图表 17 超细OCC铜键合金丝生产建设项目	47
图表 18 2015-2020年我国键合金丝未来生产情况预测分析	48
图表 19 2013年主要货币计价的黄金价格走势	53
图表 20 2012-2014年9月我国键合金丝生市场供给量分析	58
图表 21 近4年田中贵金属工业株式会社总资产周转次数变化情况	60

图表 22 近4年田中贵金属工业株式会社资产负债率变化情况60

图表 23 近4年田中贵金属工业株式会社销售毛利率变化情况61

图表 24 近4年田中贵金属工业株式会社固定资产周转次数情况61

图表 25 近4年田中贵金属工业株式会社流动资产周转次数变化情况61

图表 26 近4年田中贵金属工业株式会社产权比率变化情况62

图表 27 近4年田中贵金属工业株式会社已获利息倍数变化情况62

图表 28 近4年贺利氏控股集团总资产周转次数变化情况63

图表 29 近4年贺利氏控股集团资产负债率变化情况63

图表 30 近4年贺利氏控股集团销售毛利率变化情况63

图表 31 近4年贺利氏控股集团固定资产周转次数情况64

图表 32 近4年贺利氏控股集团流动资产周转次数变化情况64

图表 33 近4年贺利氏控股集团产权比率变化情况64

图表 34 近4年贺利氏控股集团已获利息倍数变化情况65

图表 35 近4年住友金属工业公司总资产周转次数变化情况66

图表 36 近4年住友金属工业公司资产负债率变化情况66

图表 37 近4年住友金属工业公司销售毛利率变化情况66

图表 38 近4年住友金属工业公司固定资产周转次数情况67

图表 39 近4年住友金属工业公司流动资产周转次数变化情况67

图表 40 近4年住友金属工业公司产权比率变化情况67

图表 41 近4年住友金属工业公司已获利息倍数变化情况68

图表 42 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司总资产周转次数变化情况69

图表 43 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司资产负债率变化情况69

图表 44 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司销售毛利率变化情况69

图表 45 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司固定资产周转次数情况70

图表 46 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司流动资产周转次数变化情况70

图表 47 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司产权比率变化情况70

图表 48 近4年贺利氏(招远)贵金属材料有限公司已获利息倍数变化情况71

图表 49 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司总资产周转次数变化情况71

图表 50 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司资产负债率变化情况72

图表 51 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司销售毛利率变化情况72

图表 52 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司固定资产周转次数情况72

图表 53 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司流动资产周转次数变化情况73

图表 54 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司产权比率变化情况73

图表 55 近4年贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司已获利息倍数变化情况73

图表 56 近4年杭州菱庆高新材料有限公司总资产周转次数变化情况74

图表 57 近4年杭州菱庆高新材料有限公司资产负债率变化情况75

图表 58 近4年杭州菱庆高新材料有限公司销售毛利率变化情况75

图表 59 近4年杭州菱庆高新材料有限公司固定资产周转次数情况75

图表 60 近4年杭州菱庆高新材料有限公司流动资产周转次数变化情况76

图表 61 近4年杭州菱庆高新材料有限公司产权比率变化情况76

图表 62 近4年杭州菱庆高新材料有限公司已获利息倍数变化情况76

图表 63 近4年杭州日茂新材料有限公司总资产周转次数变化情况77

图表 64 近4年杭州日茂新材料有限公司资产负债率变化情况77

图表 65 近4年杭州日茂新材料有限公司销售毛利率变化情况78

图表 66 近4年杭州日茂新材料有限公司固定资产周转次数情况78

图表 67 近4年杭州日茂新材料有限公司流动资产周转次数变化情况78

图表 68 近4年杭州日茂新材料有限公司产权比率变化情况79

图表 69 近4年杭州日茂新材料有限公司已获利息倍数变化情况79

图表 70 康强电子资产负债表80

图表 71 康强电子利润表83

图表 72 康强电子财务指标85

图表 73 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司总资产周转次数变化情况89

图表 74 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司资产负债率变化情况89

图表 75 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司销售毛利率变化情况89

图表 76 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司固定资产周转次数情况90

图表 77 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司流动资产周转次数变化情况90

图表 78 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司产权比率变化情况90

图表 79 近4年北京达博有色金属焊料有限责任公司已获利息倍数变化情况91

图表 80 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司总资产周转次数变化情况92

图表 81 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司资产负债率变化情况92

图表 82 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司销售毛利率变化情况92

图表 83 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司固定资产周转次数情况93

图表 84 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司流动资产周转次数变化情况93

图表 85 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司产权比率变化情况93

图表 86 近4年烟台招金励福贵金属股份有限公司已获利息倍数变化情况94

图表 87 贵研铂业资产负债表96

图表 88 贵研铂业利润表99

图表 89 贵研铂业财务指标101

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinshu1501/Y67504F880.html>